

各位同學好:

台灣應材為助大家成為半導體產業的設備、製程新星，即日起推出 2023 年預聘專案如下。只要你/妳嚮往加入外商、想成為一名專業的設備或製程工程師並歷練自己的客戶服務技能，歡迎加入應材，與才華洋溢的國際團隊一起工作!

**預聘職缺配對建議：**

設備團隊	製程團隊
科系: 機械/電子/電機/航太/光電/模具/船舶/輪機	科系: 化學/化工/材料/物理/光電
職缺: <b>客戶支援設備工程師 (Customer Engineer)</b> <b>全球裝機工程師(iTeam)</b> <a href="#">*台灣應材 CE 與 iTeam 的職涯觀察?</a>  <a href="#">說明連結請點此</a>	職缺: <b>製程工程師 (Process Support Engineer)</b>

**申請資格：** 2023 年應屆畢業生

**申請時間**：即日起至 **2022/12/31** 收件截止

**我要應徵**：[請點此問卷](#)報名

**\*應徵者遞交問卷後，請務必至[應用材料徵才網站](#) (搜尋”預先享應”)投遞預**

**聘職缺，上傳中英文履歷及參考附件\***

**後續流程**:

- 台灣應材招募單位將於 2023 年一月至二月上旬聯繫通過台灣應用材料初步書審之同學進行面試安排。
- 通過主管面試後即發放錄取通知書 (Offer Letter)，錄取通知書須於報到前完成學業並拿到正式畢業證書始為有效。
- 畢業後如需服兵役之學生，可於服役完畢正式退伍後再報到。

**我有疑問**: 歡迎發信至 [Recruit\\_line@amat.com](mailto:Recruit_line@amat.com)，信件名稱註明「2023 台灣應材預聘疑問」

Follow us:



台灣應用材料 人力資源部招募組 ([Recruit\\_line@amat.com](mailto:Recruit_line@amat.com))